

最新! Atomプロセッサ E600シリーズ(Tunnel Creek)ボード

Windows Embedded Standard 7/XP Embedded搭載

AtomプロセッサE600シリーズ

<CPUボードの特徴>

- 低消費電力でファンレスが可能
- CPU+ICH(CPUクロック1.3GHz版で5W)
- 産業用の厳しい環境に適合
- 車載対応の振動、衝撃をクリア可能
- 20℃~+70℃対応
- BIOSのカスタム対応可能

<概略仕様>

- CPU: Intel Eシリーズ(0.6/1.0/1.3/1.6GHz)
- ICH(チップセット): OKI ML7213
- メモリ: DDR2 512MB or 1GB Flash 8GB or 16GB
- インターフェース
- PCI-Express (x1)、USB2.0、LVDS、Digital-RGB、Video入力、SDIO、SATA、UART、GPIO、他

本ボードをコアにお客様のご要求に応じた周辺回路基板のみの開発で、開発費用と期間を短縮。さらに、CPU、OS、アプリケーションの最適な組み合わせをご提供いたします。

NAGANO 長野日本無線株式会社
NaganoJRC

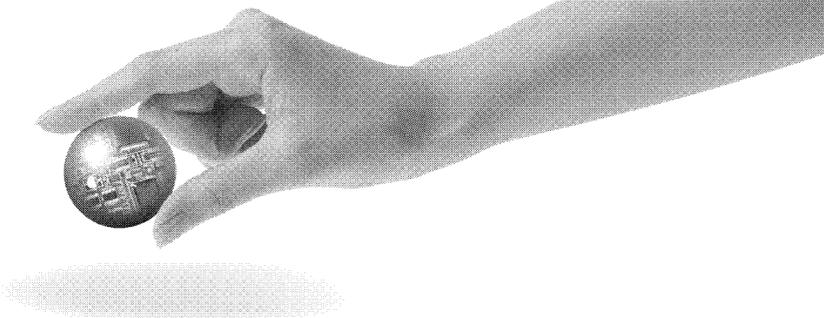
情報営業部
TEL:03(5360)4561
http://www.njrc.jp/



Embedded Technology 2011
当社ブース: B-12

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



システムLSI設計から組み込みシステムソリューションまで

お客様のニーズに、素早く、柔軟に、きめ細やかに対応

Embedded Technology 2011

パシフィコ横浜
E-34ブースに出展します



東芝情報システム株式会社

営業本部
〒210-8540 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地53
TEL:044-246-8320 FAX:044-246-8134
http://www.tjsys.co.jp/

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。



組み込みシステム開発

開発現場で生じる様々な課題に対し豊富な開発経験とノウハウを活かしたモノづくりにおけるソフトウェア全般の技術力をご提供します

モノづくりのベストパートナー

品質検証サービス

組み込みソフトウェアの品質向上という課題に対し、キャノンで培った高レベルの品質検証サービスを提供し、品質検証プロセスの改善と効率化を実現します

Canon キヤノンマーケティングジャパングループ

キャノンソフトウェア株式会社
URL: http://www.canon-soft.co.jp/

〒212-0058 川崎市幸区鹿島田890-12新川崎三井ビル
TEL:044-520-0674 FAX:044-522-5160
E-mail: embedded@canon-soft.co.jp

Embedded Technology 2011

小間No. **A-04**に出展します

長野日本無線

長野日本無線は、ワンストップで搭載した組み込みボードを出展する。新型ボードは、Atom (アトム) の E600 シリーズを搭載し、低消費電力と高いデータ処理能力が強い。タブレット端末をはじめ、タッチパネルでジェスチャーモードを可能とする業務用携帯情報端末のほか、広い温度範囲で使用できることと振動や衝撃に強いことから産業用機器向けや車載・船舶搭載製品に適している。

出展に際しては、CPU、OS、アプリケーションの最適な組み合わせを提案できる企業、を合言葉にユーザーの多様な要望に応える。米マイクロソフトの「ゴールドパートナー」として組み込み分野での実績、Intel と協力関係、村田製作所 (無線 LAN などのモジュール) との協業を武器に、ボードのカスタマイズやシステム全体の請負を増やしたい考え。

すでに E600 シリーズを用いた製品の供給先である鉄道、通信、警備、医療といった分野から各種機器の開発期間を大幅に短縮できる点で評価されている。これらの点をアピールする。

東芝情報システム

東芝情報システムは、高度化する情報機器向けの組み込みシステムとして、アプリケーション開発、プラットフォーム開発、高密度集積回路 (LSI) 設計、ライセンシング、コンサル、保守など、最先端のソリューションを提供する。中でも LSI 設計サービスでは、モデルベース開発や高価な開発ツールを必要としない、開発コストを削減できる。また、組み込み機器開発向けの環境では、シミュレーション技術を用いた LSI 設計の経験をもとに、画像処理システムを展示する。Adobe Flash の搭載経験と実績をもとに、アドビシステムズとの戦略的パートナーとして、組み込みデバイス向け Flash 製品を提供する。また、組み込み機器開発向けの環境では、シミュレーション技術を用いた LSI 設計の経験をもとに、画像処理システムを展示する。また、組み込み機器開発向けの環境では、シミュレーション技術を用いた LSI 設計の経験をもとに、画像処理システムを展示する。

TDK

TDK は産業用 Fast Charge 3B シリズや産業用 SSD、SDG 3B シリズなど展示する。また、産業用 SSD、DGB3B シリズは実効速度毎秒 190 GB の高速性能を実現した高信頼性 SATA 3B シリズなど展示する。また、産業用 SSD、DGB3B シリズは実効速度毎秒 190 GB の高速性能を実現した高信頼性 SATA 3B シリズなど展示する。また、産業用 SSD、DGB3B シリズは実効速度毎秒 190 GB の高速性能を実現した高信頼性 SATA 3B シリズなど展示する。

有力企業の技術・製品 (順不同)

EDS Fair 2011 Nov. 同時開催

「EDS Fair 2011 Nov.」が16日(水)から18日(金)までの3日間、「ET展」の同時開催展示会としてパシフィコ横浜で開かれる。いまやデジタル機器の代表ともいえる携帯電話やスマートフォンに欠かせないシステム LSI などのハードウェア・ソリューションをはじめ、ハードウェア開発環境 (EDA)、ソフトウェア・ソリューション、LSI テストに組み込みプロセッサの開発環境など、半導体・システム設計ソリューションの必須技術を網羅した専門展示会。入場料は1000円 (Web 事前登録者と招待券持参者は無料)。主催は電子情報技術産業協会 (JEITA)。開場時間は10時から17時 (17日は18時まで)。

キャノンソフトウェア

キャノンソフトウェアは、30年わたるキャノン製品のソフトウェア開発で培ってきた技術力を生かし、ソフトウェア開発から品質検証業務、開発プロセス支援まで製品開発サイクルの幅広いニーズに対応する。

開発分野はコンシューマー機器から事務機、産業機器のフレームウェア、デバイスドライバから製品に付加価値を与えるアプリケーションの開発など多岐にわたる。豊富な実績とノウハウを基に、製造業の組み込みシステム開発現場に対し技術力を提供する。

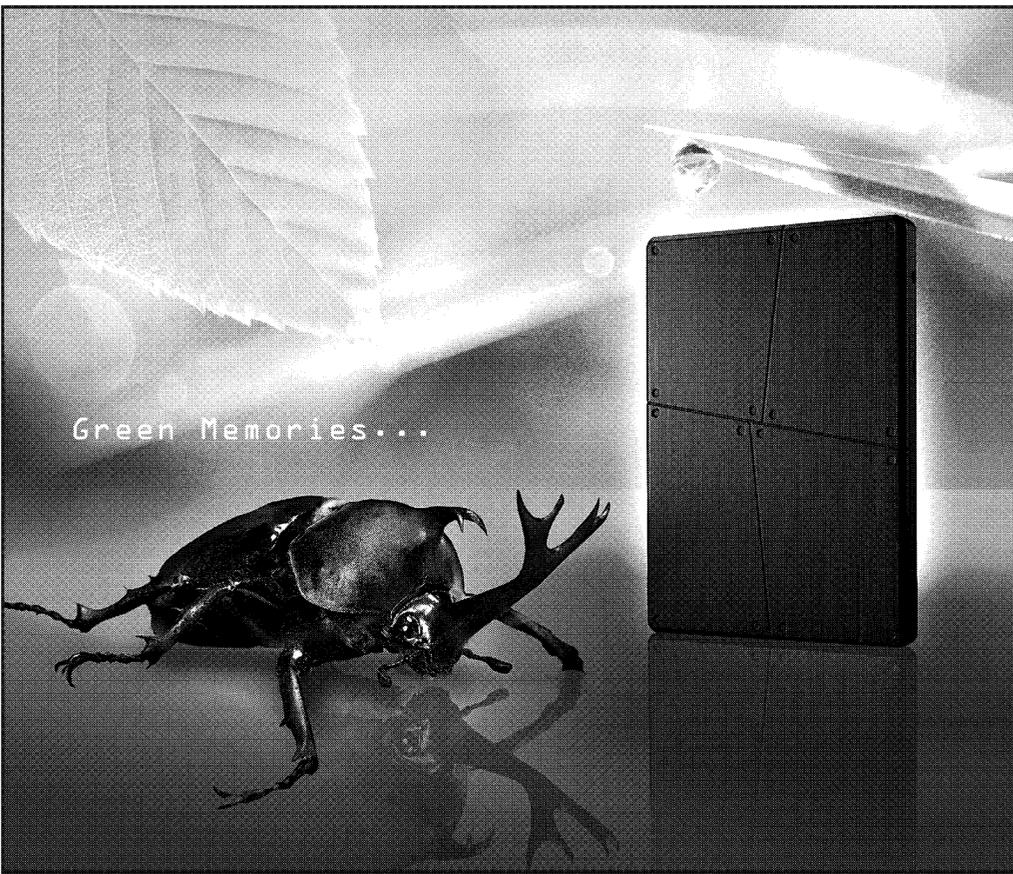
会場では保有技術の一部をデモとして展示。組み込みボード上の画像処理、パソコン上の画像認識技術や各種機器との通信技術、テスト自動化ツールを中心に、顧客ニーズへ柔軟に対応可能な組み込みシステム開発やソフトウェアメーカーならではの品質検証サービスを紹介する。

またブース内にはミニステージを設置し、キャノンソフトウェアの品質検証サービスなどを紹介していく。

富士通セミコンダクター

富士通セミコンダクターは「E CoSMART」をテーマに、暮らしのあらゆるシーンにさらにエコでスマートなものに変えるマイコン、ASIC、ARM SoC (システムオンチップ) 開発ソリューション、FRAM (不揮発性メモリ) など展示する。ARM 製 Coretex M3 コア採用した同社主力マイコン「FM3ファミリ」の展示では、モーター制御の採用事例で最先端マシナリー制御を実現した事例を、スマートシティでのスマートネットワークの応用としてアドホック通信技術を使用するスマートメーターなどを紹介。FM3ファミリとFRAMを利用した音声、発光ダイオード (LED) を制御するデモ機も展示する。さらに組み込み機器制御に適した使いやすいマイコンやネットワーク機器の待機電力を削減する LSI などを展示。

参考出展では最新の暗号マクロを搭載したシステムのセキュリティを強化するセキュリティデバイス展示。ハードウェアによる暗号化・復号化の高速処理と MPU によるソフトウェア処理を比較するデモを行う。

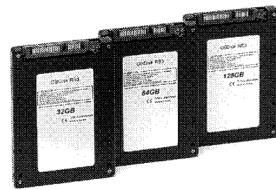


Green Memories...

“グリーンIT”時代をリードする先進SSD登場。

インターネットの普及やクラウドコンピューティングの進展などにより情報量は加速度的に急増、2025年にはIT関連機器の電力消費量は20数%を占めるようになると予測されています。そこで推進されているのが“グリーンIT”です。データセンターのサーバや産業機器においても、低消費電力、高信頼性を特長とするSSDが、HDDにかわって広く利用されるようになっていきます。TDKのSATA II対応SSD SDG3Bシリーズは、自社開発のSATAコントローラIC “GBDriver RS3”を搭載。IT関連機器、産業機器、OA機器ほか、スマートメータをはじめとするスマートグリッド関連機器などにも最適な産業用SSDです。

シリアルATA 3Gbps SSD SDG3B シリーズ



電源電圧	5V ±10%
動作温度範囲	0 to 70°C
保存温度範囲	-25 to 85°C
消費電流	295mA max. (5V Read時)
	440mA max. (5V Write時)
耐衝撃性	less than 50mA (5V/Sleep時)
耐振動性	100G (稼働時)
耐振動性	15G (動作時)

「組み込み総合技術展 / Embedded Technology 2011」に出展いたします。

会期 11月16日(水)~18日(金) 会場 パシフィコ横浜 ブース番号 B-09